05;06;07;12 Количественный рентгенотопографический анализ дефектов монокристаллов 6H–SiC и гомоэпитаксиального карбида кремния

© Г.Ф. Кузнецов

Институт радиотехники и электроники РАН, 141120 Фрязино, Московской области, Россия

(Поступило в Редакцию 30 декабря 1996 г. В окончательной редакции 19 декабря 1997 г.)

Плоские дислокационные скопления (ПДС) и сегменты криволинейных дислокаций (СКД) рассматриваются как индикаторы локальных полей сдвиговых упругих напряжений (ЛПУН), существовавших в выращиваемых монокристаллах в момент стабилизации их дислокационной структуры. Расчеты по теории дислокаций с использованием экспериментально измеренных по рентгенотопограммам (Ланга и РПКИ) параметров ПДС и СКД дали величины ЛПУН в диапазоне 0.2–1.5 · 10⁶ Ра для тонких пластинок монокристаллов SiC (6H), выращенных методом сублимации в графитовом контейнере. Обнаружен сильный неоднородный изгиб пластинок монокристаллов, для исследования дислокационной структуры которых рентгенотопографический метод РПКИ вследствие его малой чувствительности к изгибу предпочтительнее метода Ланга.

Использование подложек карбида кремния, выращенных сублимацией по методу Лели, для наращивания эпитаксиальных структур и создания целой гаммы мощных микроэлектронных и оптоэлектронных микроприборов (см., например, [1]) приводит к необходимости исследования различных типов дефектов в этих материалах. Практическим выходом таких исследований может стать оптимизация технологии для предотвращения образования некоторых типов дефектов как в процессах выращивания монокристаллов-подложек и эпитаксиальных структур, так и в процессах изготовления самих микроприборов. Наряду с электрофизическими, оптическими и электронно-микроскопическими методами в решении проблемы разработки и производства эффективно работающих и надежных микроприборов на основе SiC необходимо также применение неразрушающих методов количественного рентгеновского топографического (КРТГ) и дифрактометрического (КРД) анализа дефектов монокристаллов-подложек, выращенных эпитаксиальных структур и изготовленных на их основе самих приборных структур.

КРТГ и КРД методы занимают особую нишу среди методов исследования дефектов структуры монокристаллов и эпитаксиальных систем. Именно количественные данные этих методов уже сыграли свою существенную роль в лабораторной разработке и промышленном производстве надежных инжекционных гетеролазеров, излучающих в непрерывном режиме при комнатной температуре на длинах волн 0.85, 1.30 и $1.55 \,\mu$ m [2]. Несомненно, что данные КРТГ и КРД методов послужат физической основой для ускорения оптимизации процессов выращивания, разработки и производства надежных микроприборов с требуемыми выходными параметрами и на основе карбида кремния.

В данной работе для исследований методами КРТГ анализа были отобраны тонкие (150–400 μ m) пластинки монокристаллов α -SiC структурного типа (6H), выра-

щенных сублимацией и осаждением на стенках графитового контейнера. Пластинки имели гексагональную огранку с наибольшим развитием базисных плоскостей {0001} диаметром до 12 mm.

Для исследования дислокаций применены прямые рентгенотопографические методы Ланга [3] в коллимированных пучках характеристических излучений $K\alpha_1$ и $K\alpha_2$ Мо анода и расходящегося полихроматического пучка от квазиточечного источника (РПКИ) [2,4] с тем же анодом. При таких излучениях величина μt была в пределах 0.07–0.18. Это обеспечивало экстинкционный контраст дислокаций, регистрируемых как на топограммах, снятых по методу Ланга, так и по методу РПКИ. По методу Ланга топограммы снимались последовательно в симметричных отражениях типа {1120} и {3030}.

В отличие от метода Ланга метод РПКИ является методом многопучковой рентгенотопографии [2,4–6]. Методом РПКИ на одной фотопластинке одновременно снимались три–пять отражений типа {1120}, {3300} и {2240} основного зонального эллипса, ось которого [0001] перпендикулярна базисной поверхности кристаллов, и около 15 отражений других зональных эллипсов.

На рис. 1 приведена обзорная топограмма одного из кристаллов карбида кремния, снятая по методу Ланга в отражении (1120). На ней зарегистрированы две сравнительно узкие криволинейные полосы с четким изображением множества пересекающихся дислокационных линий. В обширной области между этими полосами изображения линий дислокаций практически не выявляются либо выявляются с чрезвычайно слабым контрастом. Это означает, что данный монокристалл 6H–SiC, как, впрочем, и все другие изученные в данной работе монокристаллы карбида кремния, имеет сильно выраженный неоднородный макроскопический изгиб. Вследствие высокой чувствительности метода Ланга к изгибу бо́лышая часть площади изучаемых монокристаллов при лауэдифракции и линейном сканировании выходит из отража-



Рис. 1. Обзорная топограмма одного из кристаллов карбида кремния (6H–SiC), снятая по методу Ланга в отражении (11 $\overline{2}0$) строго коллимированных характеристических $K\alpha_1$ - и $K\alpha_2$ -излучений анода Мо.

ющего положения и дефектная структура таких областей не выявляется, тогда как на участках топограмм от областей того же кристалла, находящихся в отражающем положении для линий $K\alpha_1$ и $K\alpha_2$ характеристического излучения анода, дислокационная структура кристаллов выявляется с отличным контрастом и с высоким линейным разрешением (около 3 μ m на рис. 1).

Как видно из топограмм от других кристаллов 6H–SiC, конфигурация отражающих областей бывает самой различной. Для данного кристалла форма отражающих областей и их положение относительно краев кристалла зависит от типа отражающих плоскостей и его точной ориентации относительно падающего пучка. Все это свидетельствует о весьма сильном неоднородном изгибе изученных монокристаллических пластинок 6H–SiC. Обнаруженный неоднородный изгиб сильно затрудняет изучение дефектной структуры кристаллов 6H–SiC методом Ланга.

Рентгенотопографический метод РПКИ, позволяющий получать достаточно хороший контраст изображения индивидуальных дислокаций в полихроматическом излучении [2,4–6], является вследствие этого значительно менее чувствительным, чем метод Ланга, к влиянию неоднородного изгиба монокристаллических пластинок. На рис. 2 приведена топограмма одного из дифракционных отражений ($30\bar{3}0$) основного зонального эллипса, снятая методом РПКИ. На ней хорошо просматривается дислокационная структура этой неоднородно изогнутой пластинки 6H–SiC. Она зарегистрировалась и в двух других отражениях, ($11\bar{2}0$) и ($21\bar{1}0$), основного зонального эллипса, а также в некоторых отражениях Методами Ланга и РПКИ в кристаллах 6H–SiC выявлены дислокации, локализованные главным образом в базисных плоскостях. Они имеют вектора Бюргерса типа $b_1 = 1/3\langle 10\bar{1}0\rangle$ и $b_2 = 1/3\langle 11\bar{2}0\rangle$. Максимальная линейная плотность дислокаций в изученных образцах кристаллов 6H–SiC была $N_d \leq 6 \cdot 10^2 \, {\rm cm}^{-1}$ в базисной плоскости, что соответствует плотности дислокаций $N_d \leq 6 \cdot 10^4 \, {\rm cm}^{-2}$ для плоскостей $\{hk10\}$, перпендикулярных базисным плоскостям скольжения дислокаций. Наряду с криволинейными наблюдались и строго прямолинейные (секториальные) дислокации, а также прямолинейные прямолинейные сегменты которых совпадают с кристаллографическими направлениями типа $\langle 11\bar{2}0\rangle$.

Для автора было главным выяснить физические причины генерации дислокаций в растущих пластинках монокристаллов 6H–SiC и определить локализацию сработавших дислокационных источников, генерировавших дислокации. Необходимо также выяснить, на какой ста-



Рис. 2. Топограммы одного из дифракционных отражений $(30\bar{3}0)$ основного зонального эллипса, снятые методом РПКИ: a — топограмма демонстрирует направление выпуклостей дислокационных полупетель и отдельных криволинейных дислокаций, стрелка указывает область сопряжения растущей монокристаллической пластинки со стенкой графитового тигля; b, c — типичные односторонние плоские дислокационные скопления (ПДС) криволинейных (b) и прямолинейных (c) дислокаций, прижатых упругими напряжениями в угловые области (b) или параллельных кристаллографическим плоскостям естественной боковой огранки гексагональных монокристаллических пластинок (c).

дии происходила генерация и распространение дислокаций — в процессе выращивания или в процессе охлаждения выросших кристаллов.

Судя по направлению выпуклостей дислокационных полупетель и отдельных ветвей криволинейных дислокаций (рис. 2, *a*), их источники были локализованы в области сопряжения растущей монокристаллической пластинки 6H-SiC со стенкой графитового тигля. Теоретический расчет термоупругих напряжений, действующих на участке закрепления кристалла со стенкой тигля, показал, что из-за больших различий величин коэффициентов термического расширения и хода их температурной зависимости в области сопряжения графита и пластинки монокристалла 6H-SiC действительно возникают термоупругие напряжения, которые, возрастая при охлаждении выросшего кристалла и тигля до комнатной температуры, могут превзойти предел прочности графита 3-44 · 10⁶ Ра [11]. Это означает, что кристаллы могут "отваливаться" от стенок контейнера в процессе охлаждения. Ростовики подтверждают, что такое явление неоднократно наблюдалось. Это дает основания полагать, что генерация дислокационных полупетель в монокристаллических пластинках 6H-SiC происходит, скорее всего, в процессе охлаждения контейнера после окончания выращивания монокристаллов.

В ряде образцов зарегистрированы типичные односторонние плоские дислокационные скопления (ПДС) криволинейных дислокаций, прижатых упругими напряжениями в базисных плоскостях в угловые области гексагональных монокристаллических пластинок (рис. 2, b). Зарегистрированы также и плоские скопления прямолинейных дислокаций (рис. 2, c), параллельных кристаллографическим плоскостям естественной боковой огранки пластинок.

Используя дислокации как индикаторы, по измеренным по топограммам и рассчитанным параметрам криволинейных дислокационных сегментов отдельных дислокаций [7] и группам плоских дислокационных скоплений (ПДС) [2,8,9] в данной работе для SiC (6H) впервые рассчитаны величины локальных упругих напряжений τ_l , которые действовали в конкретных растущих кристаллах и связаны с этими дислокациями. При этом для ПДС величины τ_l рассчитаны по формуле из [8]

$$\tau = \{ [G/(1-\nu)] \sin \alpha_n + G \cos \alpha_n \} b N_n / \pi L_n, \qquad (1)$$

где $G = 2.6 \cdot 10^{10}$ Ра — модуль сдвига, $\nu = 0.20$ — коэффициент Пуассона [10], $b = 3.1 \cdot 10^{-10}$ m — вектор Бюргерса дислокаций для 6H–SiC, α — угол вектора Бюргерса относительно линий дислокаций, L_n — длина и N_n — число дислокаций в любом из ПДС.

Сделанные по ПДС оценки величин упругих напряжений, действовавших в пластинках монокристаллов 6H–SiC в реальных условиях их выращивания, дали величину локального сдвигового напряжения $\tau_{l1} \approx 1 \cdot 10^6$ Ра (или 100 Js/mm²).



Рис. 3. Топограмма дефектов поверхности одного из кристаллов 6H–SiC, зарегистрированных в виде локальных областей черно-белого контраста различных размеров. Топограмма снята по методу РПКИ в отражении (1120) полихроматического и характеристического излучения Мо анода.

Расчеты по измеренным радиусам кривизны сегментов отдельных криволинейных дислокаций [7] дали диапазон величин локальных упругих напряжений $\tau_{l2} \approx 2 \cdot 10^5 - 1.5 \cdot 10^6$ Ра (или 20–150 Js/mm²). Как видим, величины локальных упругих напряжений, полученные разными способами для одного кристалла 6H–SiC, согласуются между собой и должны вызывать доверие. Полученный диапазон величин локальных сдвиговых упругих напряжений в реальных кристаллах 6H–SiC близок критическим величинам сдвиговых напряжений, необходимых для возбуждения дислокационных источников, генерирующих дислокации в базисных плоскостях скольжения при высоких температурах.

Зарегистрированная извилистость некоторых линий дислокаций — признак их торможения примесями, которые выделились, по-видимому, некогерентно в действующих плоскостях скольжения.

При исследовании методом РПКИ монокристаллов 6H–SiC толщиной 400 µm с нетравленой поверхностью после выращивания были обнаружены дефекты поверхности на базисных верхних плоскостях при естественной огранке кристаллов. На рис. 3 эти дефекты поверхности зарегистрированы в виде сравнительно мелких локальных областей черно-белого контраста. Их дифракционные размеры от 50 до 200-1000 µm, плотность распределения до $1 \cdot 10^4 \, \mathrm{cm}^{-2}$. Их физико-химическую природу пока можно только предполагать. Это, скорее всего, островковые осадки каких-то продуктов реакции, которые мешают действию механизма послойного наращивания монокристаллического гомоэпитаксиального слоя. Однако физически они играют роль локальных концентраторов макроскопического поля упругих напряжений, обусловленного неоднородным изгибом выращенных и охлажденных до комнатной температуры пластинок монокристаллов 6H-SiC.

На топограммах от таких образцов регистрируются только отдельные дислокации и с довольно плохим контрастом. Они как бы проглядывают или слабо просвечивают в тумане. Эффект "подавления изображения дефектов объема дефектами поверхности" в общем-то известен рентгенотопографистам. У автора по этой про-



Рис. 4. Дефектная структура одного из образцов гомоэпитаксиальной системы 6H–SiC слой–подложка, выявленная методом РПКИ в отражении (1120) полихроматического и линий характеристического излучения Мо анода.

блеме опубликовано несколько работ [2,4,6,11,12]. После химической обработки поверхности кристаллов изображения дефектов поверхности исчезают с топограмм. Следовательно, сами дефекты поверхности в результате химического растворения также исчезают с поверхности монокристаллов, что косвенно подтверждает их поверхностный островковый характер.

Методом РПКИ изучена также дефектная структура одного из образцов гомоэпитаксиальной системы 6H–SiC слой–подложка. Как выяснилось, дефектная структура подложки этой гомоэпитаксиальной однослойной структуры характеризуется весьма мощной дислокационной сеткой, дислокации которой испущены как источниками на гетерогранице кристалл–контейнер, так и одним из внутренних источников, отдаленным от гетерограницы области кристалла (стрелка на рис. 4). Контраст дислокаций подложки ослаблен влиянием неоднородного упругого поля эпитаксиального слоя.

В некоторых топограммах по РПКИ область эпитаксиального слоя оказалась частично сдвинутой относительно подложки. В этой области четко просматривается дискретное в азимутальном и брэгговском направлениях распределение интенсивности по площади топограммы, изображение на которой создано полихроматическим рентгеновским излучением. Этот контраст подобен тому, который обнаружен нами в [13] для мозаичных монокристаллических слоев CdTe, выращенных на подложках слюды. Именно по ней и можно сделать предварительное заключение, что выращенный монокристаллический слой является мозаичным. Для нас это означает, что условия наращивания гомоэпитаксиального слоя 6H–SiC были таковыми, что действовал не механизм послойного роста, характерного для идеальной гомоэпитаксии, а наращивание происходило посредством гетерогенного образования и разрастания множества трехмерных зародышей. Некоторые из них, разрастаясь, превращались в мозаичные блоки с малыми углами взаимной и максимальной разориентации. Стимулом к трехмерному зародышеобразованию при гомоэпитаксии могли послужить поверхностные загрязнения подложки, которые на других образцах обнаруживались рентгенотопографически, как дефекты поверхностного слоя монокристаллов.

Список литературы

- Lebedev A.A., Andreev A.N. et al. // Proc. VII Intern. Symp. on Power Semiconductor Devices and IC. Yokohama, 1995. P. 90–95.
- [2] Кузнецов Г.Ф. // Докт. дис. М., 1989. 466 с.
- [3] Ланг А.Р. // Прямые методы исследования дефектов в кристаллах. М.: Мир, 1965. С. 205-222, 259-267.
- [4] Кузнецов Г.Ф. // Кристаллография. 1976. Т. 21. № 2. С. 847–849.
- [5] *Кузнецов Г.Ф.* // Аппаратура и методы рентгеновского анализа. 1973. Вып. 12. С. 162–167.
- [6] Кузнецов Г.Ф., Семилетов С.А. // Обзоры по электронной технике. Сер. Микроэлектроника. М.: ЦНИИ "Электроника", 1975. Вып. 1 (280). 95 с.
- [7] Кузнецов Г.Ф. // Синтез и рост совершенных кристаллов и пленок полупроводников. Новосибирск: Наука, 1981. С. 133–138.
- [8] Кузнецов Г.Ф. Препринт ИРЭ АН СССР. М., 1986. № 2 (441). 31 с.
- [9] Кузнецов Г.Ф. // Кристаллография. 1989. Т. 34. С. 765-766.
- [10] McLaren J.R., Tappng G., Davidge R.W. // Proc. Brit. Ceram. Soc. 1972. N 20. P. 259–265.
- [11] Уббелоде А.Р., Льюис Ф.А. Графит и его кристаллические соединения. М.: Мир, 1965. 265 с.
- [12] Кузнецов Г.Ф. // Электронная техника. Сер. 8. Управление качеством и стандартизация. 1978. Вып. 3 (65). С. 39–65.
- [13] Кузнецов Г.Ф., Семилетов С.А. // Кристаллография. 1977. Т. 22. С. 664–666.